

## NOTIFICATION OF REASONS FOR REJECTION

Patent Application No.: Patent Application No. 2000-221100  
Draft Date: January 17, 2003  
Patent Office Examiner: Minoru Shimizu 8525 5W00  
Patent Applicant: Murata Manufacturing Co., Ltd.  
Applicable Sections: Section 29 (2)

The present application should be rejected for the following reasons. If you have an opinion concerning this, please submit a statement of opinion within 60 days of the date of dispatch of this notification.

## Reasons

The inventions claimed in the following claims of the present application are inventions that could easily have been invented prior to the filing of the application by a person having an ordinary knowledge of the technical field to which the inventions belong on the basis of inventions described in Publications 1 through 4 listed below, which were disseminated in Japan or in foreign countries prior to the filing of the application. Thus, in accordance with the provisions of Section 29 (2) of the Patent Law, these inventions cannot be patented.

## Note

Regarding the Inventions of Claims 1, 6 and 7:

Cited Example 1: Japanese Patent Application Kokai No. S52-130586 (see the second embodiment involving Figure 7)

OR

Cited Example 2: Japanese Patent Application Kokai No. S53-126243 (Fig. 6)

The use of a surface acoustic wave device for a communication device is common.

Regarding the Invention of Claim 4:

Cited Example 1 (The description stating, "Naturally, ... possible" is found in lines 17 and 18 in the upper-left quadrant of page 3.)

Regarding the Invention of Claim 2:

Cited Example 1 or Cited Example 2; and

Cited Example 3: Hiroshi Shimizu, "Resonator Structure Using Surface Acoustic Waves," 1975 Institute Convention of the Four Electrical Institutes, 1975, p. 845-848

The formation of an MSC on both sides of the first and second IDTs is indicated in Figure 15 (a) of Cited Example 3. Accordingly, it would be easy for a person skilled in the art to form a coupler on both sides of the first and second IDTs when utilizing the reflection from the end surfaces as in Figure 16 (a) of Cited Example 3 as well.

[Stamp: 2/13/03, Otaru]

Regarding the Invention of Claim 5:

Cited Example 1 or Cited Example 2; and

Cited Example 4: Japanese Patent Application Kokai No. H4-239214

Covering at least the surfaces of the IDTs with a gel-form or low-penetration resin in order to avoid ripples is indicated in Cited Example 4.

In regard to the invention claimed in Claim 3, no reasons for rejection have been discovered at this time. If reasons for rejection are newly discovered, you will be notified of these reasons for rejection.

End.

---

Record of Results of Survey of Prior Art References

- Field surveyed: IPC 7<sup>th</sup> Edition H 03 H 9/25
- Prior Art References: Japanese Patent Application Kokai No. S62-257211  
Japanese Patent Application Kokai No. S59-72816  
Japanese Patent Application Kokai No. S54-51759  
Japanese Patent Application Kokai No. H9-18282

This record of the results of a survey of prior art references does not constitute any reason for rejection at this time. However, it should naturally be referenced as a material to judge the technical standard at the time of filing of this application.

Inquiries: Patent Examination Department 4, Transfer Circuit, extension 6441

整理番号 29-0685P

発送番号 015993

31

発送日 平成15年 2月12日 1/2

## 特許拒絶理由通知書

4/3

特許出願の番号

特願2000-221100

起案日

平成15年 1月17日

特許庁審査官

清水 稔 8525 5W00

特許出願人

株式会社村田製作所 様

適用条文

第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

## 理由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記1~4の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

## 記

請求項1, 6, 7に係る発明について

引用例1: 特開昭52-130586号公報 (第7図に係る第2実施例参照。)

又は、

引用例2: 特開昭53-126243号公報 (Fig. 6)

表面波装置を通信機装置に用いることは通常のことである。

請求項4に係る発明について

引用例1 (第3頁左上欄第17~18行には「勿論・・・できる。」と記載されている。)

請求項2に係る発明について

引用例1又は引用例2: 及び

引用例3: 清水 洋, 弹性表面波を用いた共振子構成, 昭和50年電気四学会連合大会, 1975年, p. 845~848

引用例3図15 (a) にはMSCを第1及び第2のIDTの両側に形成することが記載されているから、引用例3図16 (a) のごとく端面の反射を利用する際にも、カプラを第1及び第2のIDTの両側に形成するようにすることは当業者にとって容易である。

請求項 5 に係る発明について

引用例 1 又は引用例 2 ; 及び

引用例 4 : 特開平 4-239214 号公報

リップル防止のため、少なくとも I D T 上をゲル状または針入度の低い樹脂で被覆することは引用例 4 に記載されている。

請求項 3 に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

以上

---

先行技術文献調査結果の記録

- ・調査した分野 I P C 第 7 版 H 0 3 H 9 / 2 5
- ・先行技術文献 特開昭 62-257211 号公報  
特開昭 59-72816 号公報  
特開昭 54-51759 号公報  
特開平 9-18282 号公報

この先行技術文献調査結果の記録は、現時点では拒絶理由を構成するものではない。しかし、出願時の技術水準を判断する資料としては当然参照されうるものである。

お問い合わせ : 特許審査第四部伝送回路 内線 6441